

智慧机房 V2.0 - 功能 #1192

功能 # 979 (完结): 温湿度项目

功能 # 1237 (完结): OM-TH100项目

功能 # 981 (完结): 硬件设计

OM-TH100温湿度改板 (C51)

2017-10-18 14:45 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-10-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-10-18
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述
1、排针位置需求按磨具定位。2、RJ45需要平行。处于同一个水平线。3、按键需要重新定位。4、显示屏需要移动定位。
5、PCB卡扣移位，主要重新定位。6、PCB扩大，和外壳一样。

历史记录

#1 - 2017-10-20 17:20 - 盘 贵星

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 0 变更为 100

2017-10-19 按照外壳实物，修改PCB板。已经下单做样。

#2 - 2017-10-28 12:34 - 盘 贵星

- 状态从 调试中 变更为 完结